

DE 30 29 939

1 / 1 WPAT - ©Thomson Derwent

Accession Nbr :

1981-91156D [50]

Title :

Laminated identity, credit or data cards - made using polymer foils, and contg.
semiconductor chip with integrated circuit for treatment of electric signals

Derwent Classes :

A84 A85 L03 P73 P76 P78 Q12 T03 T04

Patent Assignee :

(GESA) GAO GES AUTOMATION & ORG MBH

Inventor(s) :

HAGHIRI-TEHRANI Y; HOPPE J


Nbr of Patents :


14


Nbr of Countries :


9


Patent Number :


 BE-889816 A 19811116 DW1981-50 22p *


 GB2081644 A 19820224 DW1982-08
AP: 1981GB-0023899 19810805


 FR2488427 A 19820212 DW1982-11


 SE8104664 A 19820308 DW1982-12


 **DE3029939** A 19820325 DW1982-13
AP: 1980DE-3029939 19800807

 NL8103597 A 19820301 DW1982-13

 US4450024 A 19840522 DW1984-23
AP: 1981US-0288496 19810730

 GB2081644 B 19840830 DW1984-35

 CH-654127 A 19860131 DW1986-08

 US4617216 A 19861014 DW1986-44

AP: 1985US-0767057 19850819

IT1139114 B 19860917 DW1988-23

SE-458645 B 19890417 DW1989-18

DE3029939 C 19890601 DW1989-22

NL-194104 B 20010201 DW2001-10 G06K-019/00

AP: 1981NL-0003597 19810730

Priority Details :

1980DE-3029939 19800807

IPC s :

G06K-019/00 B32B-003/10 B32B-027/30 B32B-033/00 B42D-015/02

B44F-001/12 B60J-001/00 G07C-009/00 G07C-011/00 G07F-007/10 G11B-000/00

Abstract :

BE-889816 A

The chip module and its connection wires are located inside a support, which is small w.r.t. the identity card, and which forms an insert in a laminated card made by moulding or pressing and which is bonded to the entire surface of the support. The layers forming the card pref. consist of thermoplastic at least in the region of the support contg. the chip; and the thermoplastics pref. have different softening pts. One pref. thermoplastic is polythene; but the support may be locally surrounded by an elastomer, esp. polyurethane. Many other polymers may be used, one card being made from three layers of PVC, or two PVC layers sepd. by a sheet of paper.

The chip can contain a relatively large amt. of data. The support contg. the chip is securely bonded in the card.

DE Equiv. Abstract :

DE3029939 C

A multi-layer identity card has an IC module which is embedded together with its connecting leads and contacts and the carrier element on which it is mounted, in a recess of a central layer. All three layers are joined to each other by the application of heat and pressure. The layers have different softening temps. and the layer with the lowest is directly joined to the carrier element. The result is that in the initial phase during the heat-up of the layers the pressure acting directly on the carrier element is held at a lower level than in the final phase of the assembly.

ADVANTAGE - This protects the carrier element and the IC-module on it from local pressure peaks in the initial phase. (7pp)

GB Equiv. Abstract :

GB2081644 B

A method for producing a multi-layer identification card or similar data carrier having an IC-module for processing electrical signals, the IC-module with its connection leads being arranged on a separate carrier element that is small relative to the identification card, said method avoiding localised pressures in the carrier element during production of the card and comprising the steps of: providing an identification card assembly including an internal layer having a recess for the carrier element and at least one covering layer heat sealable to the internal layer; inserting the carrier element in the recess;

before or after inserting the carrier element in the recess, establishing a buffer zone at least in the area of the carrier element for limiting the application of force to the carrier element; and applying heat and pressure to the identification card assembly to heat seal the layers together, said buffer zone limiting the application of force to the carrier element to avoid localised pressure on the carrier element.a

US Equiv. Abstract :

US4450024 A

Multilayer identification card including an I.C. module for processing electric signals is mfd. without applying localised pressures to the module.

The module is located on a carrier in a recess in an internal layer and a buffer is established near the carrier to limit the force applied to the module.

The internal layer and the assembled other layers are then heated and pressed to heat seal. (7pp)u
US4617216 A

Multilayer data card contg. accessible, electronically encoded data, comprises a card composite having an internal core layer and at least one covering layer laminated by heat and press. to one side of the core layer. Core layer has a recess. A carrier element having a data containing Ic-module member which can be accessed is received in the recess and laminated into the card composite by the covering layer. The carrier element is completely surrounded in the recess by a material having a softening point lower than that of the core layer. The material is pref. polyethylene or polyurethane and is used for protecting the carrier element against mechanical stresses.

ADVANTAGE - Improves the laminating process. (4pp)f

Manual Codes :

CPI: A12-D A12-E05 A12-E07 L03-B02

EPI: T03-A01C T04-C

Update Basic :

1981-50

Update Equivalentents :

1982-08; 1982-11; 1982-12; 1982-13; 1984-23; 1984-35; 1986-08; 1986-44; 1988-23; 1989-18; 1989-22; 2001-10

①⑨ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



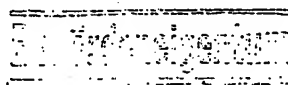
DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑪ **DE 3029939 A1**

⑤① Int. Cl. 3:
G06K 19/00
G 07 C 9/00
B 44 F 1/12
B 42 D 15/02

②① Aktenzeichen:
②② Anmeldetag:
④③ Offenlegungstag:

P 30 29 939.9
7. 8. 80
25. 3. 82



⑦① Anmelder:

GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH,
8000 München, DE

⑦② Erfinder:

Hoppe, Joachim; Haghiri-Tehrani, Yahya, Dipl.-Ing., 8000
München, DE

⑤④ Ausweiskarte mit IC-Baustein und Verfahren zu ihrer Herstellung

DE 3029939 A1

GAO Gesellschaft für
Automation und
Organisation mbH
Euckenstr. 12
8000 München 70

Ausweiskarte mit IC-Baustein und Ver-
fahren zu ihrer Herstellung

Patentansprüche:

- ① Ausweiskarte oder ähnlicher Datenträger mit einem IC-Baustein zur Verarbeitung elektrischer Signale, wobei der IC-Baustein zusammen mit seinen Anschlußleitungen auf einem separaten, im Vergleich zur Ausweiskarte kleinem Trägerelement angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägerelement in einen Kartenverbund einlaminieren und mit der Ausweiskarte allseitig und ganzflächig verbunden ist.

2. Ausweiskarte nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t, daß der Schichtaufbau der Karte zu-
mindest im Bereich des Trägerelementes derart gewählt
ist, daß thermoplastische Materialien mit unter-
5 s ch i e d l i c h e n Erweichungspunkten übereinander ange-
ordnet sind.
3. Ausweiskarte nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t, daß das Trägerelement vollständig von
10 e i n e m thermoplastischen Material umgeben ist, dessen Erwei-
chungspunkt unter dem der übrigen Kartenschichten liegt.
4. Ausweiskarte nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
g e k e n n z e i c h n e t, daß das thermoplastische
15 M a t e r i a l Polyäthylen ist.
5. Ausweiskarte nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t, daß der Schichtaufbau der Karte zu-
mindest im Bereich des Trägerelements derart gewählt
20 i s t, daß mindestens eine Schicht aus einem im Kalt-
zustand gegenüber anderen Schichten weichen und elasti-
schen Material besteht.
6. Ausweiskarte nach Anspruch 5, dadurch g e k e n n -
25 z e i c h n e t, daß das Material Polyurethan ist.
7. Ausweiskarte nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
g e k e n n z e i c h n e t durch folgenden Schicht-
aufbau: PVC / PVC und/oder Papier / PVC.

8. Ausweiskarte nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
g e k e n n z e i c h n e t durch folgenden
Schichtaufbau: PVC / Schmelzkleber / PVC und/oder
Papier / Schmelzkleber / PVC.
- 5
9. Ausweiskarte nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
g e k e n n z e i c h n e t durch folgenden Schicht-
aufbau: Verbundfolie aus PVC / PE, PE, Papier, PE,
Verbundfolie aus PE / PVC.
- 10
10. Ausweiskarte nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
g e k e n n z e i c h n e t durch folgenden Schicht-
aufbau: Verbundfolie aus PETP / PE, Verbundfolie aus
PE / PVC, PVC oder Papier, Verbundfolie aus PVC / PE,
Verbundfolie aus PE / PETP.
- 15
11. Ausweiskarte nach einem oder mehreren der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch g e k e n n z e i c h n e t,
daß die das Trägerelement überdeckenden Schichten
zumindest teilweise lichtdurchlässig sind.
- 20
12. Verfahren zur Herstellung von mehrschichten Aus-
weiskarten mit einem IC-Baustein zur Verarbeitung
elektrischer Signale wobei der IC-Baustein zusammen
mit seinen Anschlußleitungen auf einem separaten,
im Vergleich zur Ausweiskarte kleinen Trägerelement
angeordnet ist und der IC-Baustein in eine Aus-
sparung einer mittleren Schicht eingesetzt wird,
dadurch g e k e n n z e i c h n e t, daß die
Schichten unter Anwendung von Wärme und Druck
- 25
- 30

- 4 -

ganzflächig miteinander verbunden werden und daß
während der Erwärmungsphase der Ausweiskarten-Schich-
ten der Kaschierdruck zumindest im Bereich des Träger-
elements geringer gehalten wird als in der Endphase
5 der Kaschierung.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t, daß zumindest im Bereich des Träger-
elements eine oder mehrere Pufferzonen vorgesehen
10 werden, durch die der volle Kaschierdruck vor der
Erweichungsphase der Schichten vom Trägerelement
ferngehalten wird.
14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch g e k e n n -
15 z e i c h n e t, daß die Pufferzone durch einen Hohl-
raum zwischen dem Trägerelement und der Deckfolie
gebildet wird.
15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch g e k e n n -
20 z e i c h n e t, daß die Pufferzone durch eine Schicht
mit gegenüber den Deckschichten niedrigerem Erweichungs-
punkt gebildet wird.
16. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch g e k e n n -
25 z e i c h n e t, daß die Pufferzone (n) durch eine
wenigstens teilweise Ummantelung des Trägerelements
gebildet wird, deren Erweichungspunkt geringer ist
als der der übrigen Kartenschichten.
17. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch g e k e n n -
30 z e i c h n e t, daß die Pufferzone

- 5 -

durch eine elastische Beschichtung der Kaschierplatten gebildet wird.

- 5 18. Verfahren nach einem der Ansprüche 13, 15 oder 16, dadurch g e k e n n z e i c h n e t, daß eine als Pufferzone wirkende Schicht oder Ummantelung des Trägerelements aus einem Material besteht, das gegenüber den anderen Kartenschichten im Kaltzustand weich und elastisch ist.
- 10 19. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch g e k e n n z e i c h n e t, daß die Kaschiervorrichtung in Abhängigkeit von der Temperatur gesteuert wird.
- 15 20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch g e k e n n z e i c h n e t, daß die Kartenschichten zunächst bis zum Erweichungspunkt der dem Trägerelement benachbarten Schichten erwärmt und anschließend zusammengepreßt werden.

20

25

Die Erfindung betrifft eine Ausweiskarte oder einen ähnlichen Datenträger mit einem IC-Baustein zur Verarbeitung elektrischer Signale, wobei der IC-Baustein zusammen mit seinen Anschlußleitungen auf einem im Vergleich zur Ausweiskarte kleinen separaten Träger-
5 element angeordnet ist. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Ausweiskarte.

10 Ausweiskarten mit eingelagertem IC-Baustein sind seit längerer Zeit bekannt. So ist beispielsweise in der DE-OS 26 59 573 ein IC-Baustein beschrieben, bei dem alle Anschlußleitungen auf einer separaten, aus steifem Material bestehenden Trägerplatte angeordnet sind. Die
15 Trägerplatte wird in eine entsprechend vorbereitete Ausparung der Karte eingeklebt oder an ihren Rändern durch ein Hochfrequenz-Schweißverfahren mit der Karte verbunden. Diese Verfahren belasten die Anordnung sowohl thermisch als auch mechanisch in nur geringem Maße,
20 sind aber bezüglich der Kartenproduktion aufwendig, da mehrere und zum Teil technologisch komplizierte Verfahrensschritte zur Herstellung der Ausweiskarte durchzuführen sind. Der Einbau des Trägerelements ist bei dieser bekannten Ausweiskarte im sogenannten Prägebereich
25 vorgesehen, so daß diese Karten den üblichen Normen, die den Prägebereich ausschließlich für Prägnungen vorsehen, nicht genügen.

Die Aufgabe der Erfindung besteht deshalb darin, eine
30 Ausweiskarte mit einem IC-Baustein vorzuschlagen, die die genannten Nachteile vermeidet und die mit erheblich vermindertem Aufwand gefertigt werden kann.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch gelöst,

daß das Trägerelement in einen Kartenverbund laminiert und mit der Ausweiskarte allseitig und ganzflächig verbunden ist. Das Herstellungsverfahren zeichnet sich dadurch aus, daß während der Erwärmungsphase der Aus-
5 weiskarten-Schichten der Kaschierdruck zumindest im Bereich des Trägerelements geringer gehalten wird als in der Endphase der Kaschierung.

Die Erfindung nutzt die seit längerer Zeit bekannte
10 und in der Praxis bewährte Heißkaschiertechnik, um in einem einzigen Arbeitsgang während der Verschmelzung der einzelnen Kartenschichten das mit der IC-Anordnung und den Anschlußleitern versehene Trägerelement in den Kartenverbund einzubringen.

15 Die Verarbeitung eines separaten und von der AK-Herstellung unabhängig gefertigten Trägerelements zur Herstellung von IC-Ausweiskarten unter Anwendung der sogenannten Heißkaschiertechnik erweist sich dabei als
20 besonders vorteilhaft.

Das Trägerelement, das neben dem integrierten Schaltkreis auch sämtliche Anschlußleitungen trägt, ist besonders geeignet, mechanischen Belastungen standzu-
25 halten. Das gilt vor allem für die Belastungen, denen die Ausweiskarte in ihrem täglichen Gebrauch ausgesetzt ist.

Die Anwendung einer in der Praxis seit langem erprobten
30 Kaschiertechnik bietet die Möglichkeit der rationellen Herstellung der Karten.

Im übrigen zeichnen sich heißkaschierte Ausweiskarten durch ein hervorragendes Erscheinungsbild aus, was unter

anderem durch die glatten und hochtransparenten Deckschichten der Karte bedingt ist. Daneben sind heißkaschierte Ausweiskarten sehr fälschungssicher, weil diese Technik ein hohes Maß an praktischen Erfahrungen
5 erfordert und weil die einzelnen Schichten einer heißkaschierten Ausweiskarte nur unter Zerstörung der Karte wieder voneinander trennbar sind.

Es sind schon Ausweiskarten mit integriertem Schaltkreis bekannt geworden, die bei der Herstellung der Karten die Anwendung von Wärme bzw. von Wärme und Druck erwähnen (DE-OS 22 20 721, DE-OS 26 33 164). In den Veröffentlichungen geht man im Gegensatz zur Erfindung jedoch von einem vollkommen anderen Grundaufbau der
15 IC-Karte aus. Das Leiternetz des integrierten Schaltkreises ist großflächig auf einer mittleren Kartenschicht angeordnet. Bei diesen Anordnungen sind die Verbindungspunkte zwischen Leiternetz und IC-Anordnung sowohl während der Herstellung der Karte als auch während
20 ihrer Handhabung stark gefährdet.

Die Vorveröffentlichungen, die die Ausweiskarten-Herstellung nur am Rande erwähnen, sind bezüglich der Ausweiskarten-Technologie nicht an der Praxis orientiert.
25 Die Herstellungsverfahren sind aus der herkömmlichen Ausweiskarten-Herstellung übernommen, ohne die spezifischen Probleme zu berücksichtigen, die sich beim Einbau von IC-Bausteinen einschließlich der Anschlußleitungen in Ausweiskarten ergeben.

30 Im Gegensatz dazu wird in der DE-OS- 26 59 573 den in der Praxis bei der IC-Ausweiskarten-Herstellung und -Handhabung auftretenden Problemen erstmals Rechnung getragen. In ihr wird darauf hingewiesen, daß die

Herstellung in einem Heißkaschierverfahren nicht möglich ist, da insbesondere durch die thermische Belastung die IC-Anordnung zu stark gefährdet wird. Zur Umgehung der daraus entstehenden Schwierigkeiten wird deshalb ein anderer, 5 wesentlich aufwendigerer und fertigungsunfreundlicherer Weg der Kartenherstellung beschritten. Obwohl die in der DE-OS 26 59 573 gegen das Heißkaschierverfahren vorgebrachten Argumente durch eine Vielzahl von Versuchen erhärtet werden konnten, zeigte sich, daß die Herstellung von IC-Ausweiskarten 10 in sogenannter Heißkaschiertechnik dennoch möglich ist, wenn zum Schutz des IC-Bausteins und seiner Anschlußleitungen besondere Vorkehrungen getroffen werden. Es hat sich außerdem gezeigt, daß neben der thermischen Belastung die während des Kaschiervorgangs auftretende hohe mechanische Belastung 15 die IC-Anordnung im gleichen Maß gefährden kann, vor allem, wenn im Bereich der Anordnung örtliche Druckspitzen auftreten. Derartige Belastungen können das Siliziumplättchen zerbrechen bzw. die Verbindungsstellen des Kristalls mit den Anschlußleitungen, die aufgrund der Wärmeeinwirkung 20 ohnehin gefährdet sind, zerstören.

Der Grundgedanke der Erfindung besteht im wesentlichen darin, daß das Trägerelement erst nach Erweichen einer oder mehrerer Schichten des Kartenverbundes mit dem vollen Kaschierdruck 25 belastet wird. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, daß in dem noch nicht laminierten Kartenverbund oder der Kaschiervorrichtung Pufferzonen vorgesehen sind, durch die der volle Kaschierdruck in der Anfangsphase vom Trägerelement ferngehalten wird. Eine weitere Möglichkeit ergibt 30 sich durch die Steuerung des Kaschierdrucks in Abhängigkeit von der Temperatur bzw. dem Erweichungsgrad der Ausweiskartenschichten. Das Auftreten von örtlichen Druckspitzen ist nicht möglich, da durch die erfindungsgemäßen Ausführungen der volle Kaschierdruck stets großflächig über das bereits erweichte oder im Kaltzustand elastisch verformbare

und das Trägerelement umgebende Material übertragen wird.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand von Unteransprüchen. Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der beigefügten Zeichnung näher beschrieben. Darin zeigen:

- 10 Fig. 1 die Draufsicht auf eine Ausweiskarte mit eingelagertem integrierten Baustein,
- Fig. 2a, b eine erste Ausführungsform des Kartenaufbaus vor und nach dem Kaschieren im Schnitt,
- 15 Fig. 3a, b eine zweite Ausführungsform des Kartenaufbaus vor und nach dem Kaschieren im Schnitt,
- 20 Fig. 4a, b eine dritte Ausführungsform des Kartenaufbaus vor und nach dem Kaschieren im Schnitt, und
- 25 Fig. 5a, b eine vierte Ausführungsform des Kartenaufbaus vor und nach dem Kaschieren im Schnitt.

Die Fig. 1 zeigt eine Ausweiskarte 1 mit einem eingelagerten IC-Baustein 5. Der IC-Baustein selbst ist in einem Trägerelement 6 untergebracht, das in dem gezeigten Ausführungsbeispiel scheibenförmig ausgebildet ist. Zur Kontaktabnahme sind die Kontaktflächen 7 vorgesehen.

Das Trägerelement 6 wird unabhängig von der Kartenherstellung produziert. Der Aufbau des Trägerelementes,

die Art der verwendeten Materialien, die Anordnung und Ausbildung der Kontakte können abhängig vom Herstellungsaufwand sowie vom Einsatzbereich der Elemente in der fertigen Ausweiskarte stark variieren.

5

Die in der Fig. 1 gezeigte Ausweiskarte entspricht in ihren Abmaßen, sowie in der Anordnung weiterer Funktionsbereiche der ISO-Norm. Danach befindet sich der Magnetstreifen 15 auf der Rückseite der Karte, wie auch in den

10 Fig. 2a, b gezeigt.

Für maschinenlesbare und nicht maschinenlesbare geprägte Daten sind die Felder 9 bzw. 10 vorgesehen.

15 Die Fig. 1 zeigt eine vorteilhafte Anordnung des Trägerelements 6 außerhalb der Prägefelder 9 bzw. 10 in einem belastungsarmen Bereich der Karte.

Die nachfolgend beschriebenen Ausführungsformen zeigen
20 beispielhaft aufgrund welcher Maßnahmen örtliche Druckspitzen vom Trägerelement ferngehalten werden, obwohl der gesamte Kartenverbund, einschließlich des Bereichs, in dem das Trägerelement angeordnet ist, zumindest in der Endphase des Kaschierprozesses mit dem vollen
25 Kaschierdruck belastet wird.

Es ist damit möglich, auch Ausweiskarten mit integriertem Schaltkreis in der Qualität herkömmlicher heißkaschierter Karten herzustellen ohne den Schaltkreis
30 mit seinen Anschlußleitungen zu gefährden.

Die Fig. 2a und 2b zeigen ein erstes Ausführungsbeispiel der Erfindung vor und nach dem Kaschierprozeß. Die Proportionen der Einzelelemente der Karte sind in diesem

und den nachfolgenden Ausführungsbeispielen des besseren Verständnisses wegen nicht immer maßstabsgetreu dargestellt.

- 5 Der einfache, in einem Schnitt dargestellte Kartenverbund besteht aus einem gegebenenfalls mehrschichtigen und bedruckten Kartenkern oder Karteninlett 11 und den Deckfolien 12 und 13. Kartenkern und Deckfolien können aus PVC (Polyvinylchlorid) bestehen. Als Karten-
10 inlett kann auch Papier verwendet werden. Zur Aufnahme des Trägerelements 6 ist das Karteninlett mit einer eng angepaßten Aussparung versehen. Die Dicke des Karteninletts 11 ist relativ zur Dicke des Trägerelements 6 so gewählt, daß sich bei dem unkaschierten Kartenver-
15 bund zwischen der Oberfläche des Trägerelements und der Deckfolie 12 ein Hohlraum 14 ergibt.

- Aufgrund der durch den Hohlraum 14 gebildeten Pufferzone wird das Trägerelement in der Anfangsphase des Kaschier-
20 prozesses nur geringfügig belastet. Im weiteren Verlauf des Kaschiervorgangs wird der Kartenverbund allmählich aufgeheizt, so daß die PVC-Schichten erweichen. In der Erweichungsphase der Schichten verschwindet der Hohlraum 14 und der gesamte Kaschierdruck wird nun auch
25 im Bereich des Trägerelements 6 wirksam. In dieser Phase bilden die erweichten Schichten ein Polster, das örtliche Druckspitzen vom Trägerelement fernhält.

- Wie man an dem kaschierten Kartenverbund sieht (Fig. 2b)
30 wird das Trägerelement 6 allseitig und ganzflächig mit der Ausweiskarte 1 verbunden; d. h. einlaminiert. Dabei wird ein u. U. vorgesehener Magnetstreifen 15 derart in das Folienmaterial eingebettet, daß sich eine glatte Oberfläche auch im Bereich des Magnet-

streifens ergibt.

- Die Kontakte oder Koppelungselemente 7 sind in dem Ausführungsbeispiel durch die Folie 12 abgedeckt. Diese
- 5 Ausführungsform ist daher für eine berührungslose Kontaktabnahme (beispielsweise kapazitiv oder optisch) geeignet. Wird die Energieübertragung auf optischem Weg vorgenommen, ist die Deckfolie 12 im Bereich der Koppelungselemente 7 entsprechend der verwendeten
- 10 Lichtart durchlässig zu gestalten. Bei der Verwendung von IR-Licht kann die Deckfolie im Bereich der Trägerelemente geschwärzt sein, womit gleichzeitig Störlicht von der IC-Anordnung ferngehalten wird.
- 15 Grundsätzlich kann eine Kontaktabnahme auch berührend durchgeführt werden, wenn man z. B. die Deckschicht 12 zur Kontaktierung mit geeigneten Kontaktelementen durchsticht.
- 20 Die Fig. 3a und 3b zeigen eine zweite Ausführungsform der Erfindung bei der eine oder mehrere Pufferzonen durch Zwischenschichten im Kartenverbund beispielsweise durch einen sogenannten Kaschierkleber gebildet werden. Dazu beschichtet man vor dem Kaschiervorgang die Deck-
- 25 folien 12 und 13 mit dem Kaschierkleber 17 (Fig. 3a).

- Zu diesem Zweck geeignete Kleber (z. B. Polyurethan-Heißschmelzkleber) sollen bei Normaltemperatur elastisch sein und eine Erweichungstemperatur aufweisen, die unter
- 30 der Erweichungstemperatur der für den Kartenverbund gewählten Deckschichten liegt.

Bei der genannten Ausführungsform wird die Aussparung des Kartenkerns 11 mit einem Durchmesser gestanzt, der

größer ist als der Durchmesser des Trägerelements 6
Aufgrund dessen ergibt sich - neben dem schon in der
Fig. 2a gezeigten Hohlraum 14 - rings um das Trägerele-
ment 6 ein freier Spalt 18. Die Aussparung braucht
5 in diesem Fall nicht in so engen Toleranzen an das
Trägerelement angepaßt zu werden, wie bei der in Fig.
2a gezeigten Anordnung.

Auch bei dem in der Fig. 3a gezeigten Kartenaufbau
10 wird das Trägerelement in der Anfangsphase des Kaschier-
prozesses nahezu nicht belastet. Sobald die Kaschier-
temperatur die Erweichungstemperatur des Klebers 17
erreicht und schließlich übersteigt, fließt der Kaschier-
kleber 17 in die vorhandenen Hohlräume 14 und 18 und
15 bildet dabei eine homogene Ummantelung des Träger-
elements 6.

Das so vor örtlichen Druckspitzen geschützte Trägerele-
ment kann nun den vollen Kaschierdruck flächig aufnehmen
20 und an die Umgebung übertragen. Inzwischen haben auch
die Deckschichten die Erweichungstemperatur erreicht, so
daß sich schließlich ein inniger Verbund aller Schichten
untereinander und mit dem allseitig eingeschlossenen
Trägerelement ergibt.

25 Bei der fertig kaschierten Ausweiskarte (Fig. 3b) ist
das Trägerelement 6 von dem im Kaltzustand elastischen
Kleber 17 umgeben, der die im täglichen Gebrauch der
Karte auftretenden mechanischen Belastungen weitgehend
30 vom Trägerelement fernhält.

Polyurethan kann als Schmelzkleber aber auch in Form
einer Schmelzkleberfolie im Kartenverbund verarbeitet
werden. Verwendet man im Kartenverbund eine sehr weiche

Polyurethan Schmelzkleberfolie (z. B. Platilon U02) dann ist es möglich, die Dicke der einzelnen Kartenschichten relativ zur Dicke des Trägerelements in den Toleranzen so zu wählen, daß der Hohlraum 14 sehr klein wird oder unter Umständen ganz verschwindet. Eine sehr weiche Schmelzkleberfolie ist in der Lage, auch im Kaltzustand des Kartenverbundes, örtliche Druckspitzen in gewissem Umfang aufzunehmen. Mit dem Erweichen der Folie läuft dann der Kaschiervorgang wie oben geschildert ab.

In den Fig. 4a und 4b ist ein drittes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Kartenaufbaus gezeigt, bei dem die Pufferzonen unter anderem unter Verwendung von Verbundfolien gebildet werden.

Die in der Fig. 4a dargestellte Anordnung zeigt den Aufbau der Kartenschichten vor der Kaschierung.

Der mehrschichtige Kartenkern besteht aus einer Papierschicht 23 und den beidseitig dieser Schicht angeordneten Folien 22 und 24. Letztere bestehen aus dem thermoplastischen Werkstoff Polyäthylen (PE). PE kann abhängig von der Dichte bezüglich seiner mechanischen und thermischen Eigenschaften innerhalb weiter Bereiche variiert werden. PE geringer Dichte ist im Gegensatz zu PVC relativ weich bei hohem plastischen Deformierungsvermögen und niedrigem Erweichungspunkt.

In den erweiterten Kartenkern wird abhängig vom Durchmesser des Trägerelements eine Aussparung gestanzt, die rund um das Trägerelement einen freien Spalt läßt. Die Dicke der einzelnen Schichten des Kartenkerns wird relativ zur Dicke des Trägerelements so gewählt, daß

- auch zwischen dem Trägerelement und den sich anschließenden Deckschichten 21 und 22 ein Hohlraum 29 bleibt. Die Deckschichten 20 und 21 und 25 und 26 bestehen aus Polyäthylen-beschichteten Polyvinylchlorid-Folien, die als Verbundfolien verarbeitet werden. Die obere Deckschicht 20, 21 ist zur Durchführung der Kontakte 30 des Trägerelements mit geeigneten Aussparungen 31 versehen.
- 10 Im Kaltzustand wird das Trägerelement aufgrund des gewählten Schichtaufbaus durch den Druck der Kaschierplatte nur unwesentlich belastet. Im Laufe des Kaschierprozesses kommen zunächst die PE-Schichten in die Fließphase, so daß die vorhandenen Hohlräume 28, 29 mit dem PE-Material ausgefüllt werden. Die Ummantelung schützt das Trägerelement bei dem in der Endphase des Kaschierens notwendigen hohen Druck vor örtlichen Druckspitzen und bietet außerdem im täglichen Gebrauch der Karte eine gute Schutzmaßnahme gegen mechanische
- 20 Verformungen.

Bei der in Fig. 4b gezeigten Ausführungsform einer IC-Ausweiskarte sind die Kontakte des Trägerelements an die Oberfläche der Deckschicht geführt, so daß in diesem Fall eine berührende Kontaktabnahme möglich ist.

In den Fig. 5a bzw. 5b ist ein viertes Ausführungsbeispiel der Erfindung gezeigt, bei dem zur Bildung der Pufferzonen ausschließlich sogenannte Verbundfolien verwendet werden.

Die in diesem Beispiel als Deckschichten vorgesehenen Verbundfolien sind Polyesterfolien (PETP) 32, bzw. 40, die mit Polyäthylen (PE) 33, bzw. 39 beschichtet sind.

Die sich symmetrisch anschließenden zweiten Verbund-
folien bestehen aus PE 34, 38 und PVC 35, 37. Der
eigentliche Kartenkern 36 kann aufgrund dieses spe-
ziellen Kartenaufbaus wahlweise aus PVC oder aus Papier
5 bestehen.

Die Fig. 5b zeigt die Ausweiskarte nach dem Kaschier-
vorgang, der wie im Zusammenhang mit den Fig. 4a, 4b
erläutert ablaufen kann. Wie erwähnt, bestehen die
10 Deckfolien der letztgenannten Ausweiskarte aus einem
speziellen Polyester.

PETP (Polyäthylenglykolteterephthalat) ist ein thermo-
plastischer Polyester mit sehr hoher Festigkeit, hoher
15 Abriebfestigkeit, geringer Schrumpfung und hohem
Erweichungspunkt. Diese Folien sind somit für Ausweis-
karten, die im täglichen Gebrauch hohen Belastungen aus-
gesetzt sind, besonders gut geeignet.

20 Da die verwendeten Polyesterfolien beispielsweise im
Gegensatz zu PVC-Folien nur eine geringe Schrumpf-
neigung zeigen, ist es möglich, den Kartenverbund zu-
nächst ohne Anwendung von Druck zu erwärmen bis die PE-
Schichten in die Fließphase übergehen. Der so erweichte
25 Kartenverbund wird anschließend unter Druck zusammen-
gepreßt. So kann z. B. bei der sogenannten Rollenka-
schierung das Zusammenpressen der zuvor in einer Wärme-
station erweichten Kartenschichten mit Hilfe zweier
Walzen durchgeführt werden.

30

Bei den vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispielen
sind zum Schutz des Trägerelements im Schichtaufbau des
Kartenverbundes Pufferzonen vorgesehen.

- Daneben ist es selbstverständlich auch möglich, das Trägerelement selbst - vor der Kaschierung - ganzflächig oder partiell mit einer Pufferzone zu versehen. Brauchbare Materialien, deren Eigenschaften sowie deren Verhalten während des Kaschierprozesses sind im Zusammenhang mit der Beschreibung der Fig. 3a und 3b erwähnt worden. Für eine ganzflächige Ummantelung könnte das Trägerelement in ein geeignetes Harz getaucht werden.
- 5
- 10 Besteht das Trägerelement selbst aus steifem Material, kann eine partielle Beschichtung des Elements beispielsweise durch Abdeckung der Kontaktseite mit einer Schmelzkleberfolie als Pufferzone vorgesehen werden.
- 15 Eine weitere Möglichkeit, das Trägerelement während der Kaschierung vor örtlichen Druckspitzen zu schützen, besteht darin, daß man die Kaschierplatten zumindest im Bereich des Trägerelements mit einem weichen, flexiblen Material beschichtet. Dazu eignet sich beispielsweise
- 20 Silikongummi.

Schließlich ist es auch möglich, das Trägerelement beim Einbau in Ausweiskarten gegen punktuelle mechanische Belastungen zu schützen, wenn der Kaschierdruck in Abhängigkeit von der Temperatur geregelt wird. Dabei ist die Schrumpfeigung der jeweils verwendeten Folienart zu berücksichtigen, die mit der Temperatur steigt.

25

Man wird also den Kaschierdruck abhängig von der Temperatur derart erhöhen, daß die beteiligten Folien sich nicht verziehen, andererseits aber das Trägerelement in der Endphase des Kaschierprozesses, nachdem die Kartenschichten erweicht sind, mit dem vollen Kaschierdruck belastet wird. Mit dem Verfahren der Steuerung des

30

Kaschierdrucks in Abhängigkeit von der Temperatur lassen sich Integrierte Schaltkreise gefahrlos in Ausweiskarten einbetten, ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen vorsehen zu müssen.

5

Andererseits kann es sich für bestimmte Anwendungsfälle, beispielsweise bei der Verarbeitung von Folien mit hoher Schrumpfnegung als vorteilhaft erweisen, wenn das Verfahren der Steuerung des Kaschierdrucks mit einer oder
10 mehreren der oben genannten Schutzmaßnahmen kombiniert wird.

Nummer:
 Int. Cl.³:
 Anmeldetag:
 Offenlegungstag:

3029939
 G 06 K 19/00
 7. August 1980
 25. März 1982

- 2 A -

NAOHGEREICHT

3029939

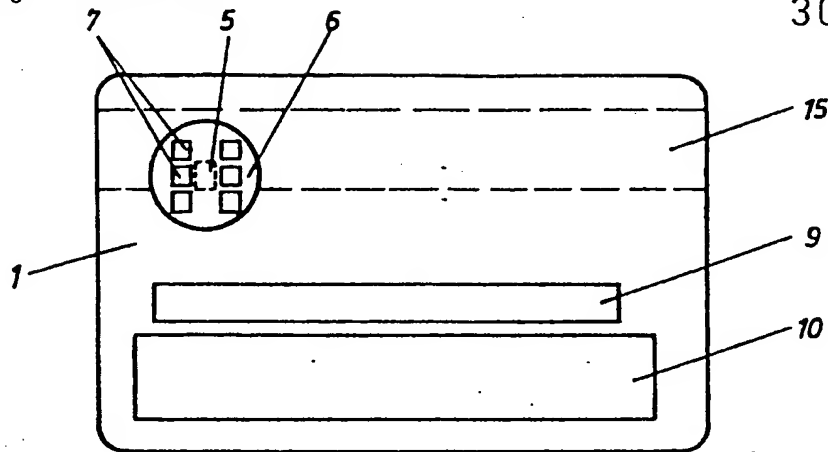


Fig. 1

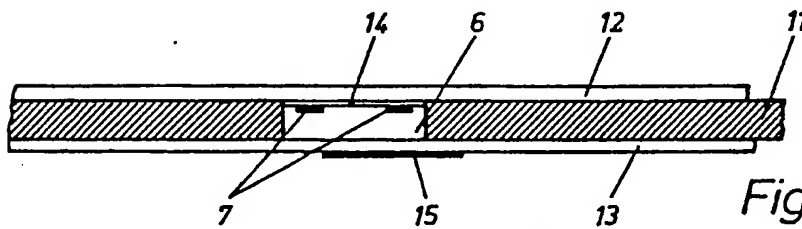


Fig. 2a

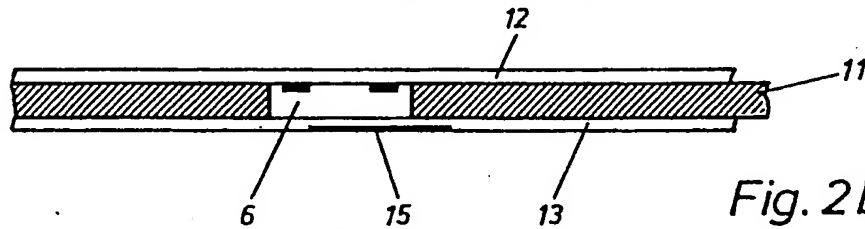


Fig. 2b

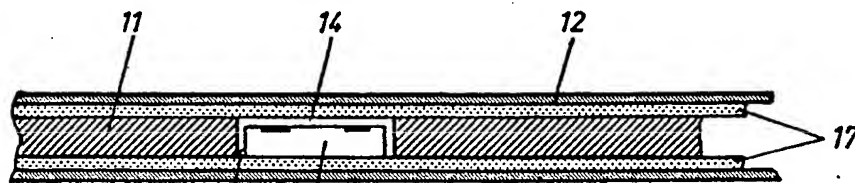


Fig. 3a

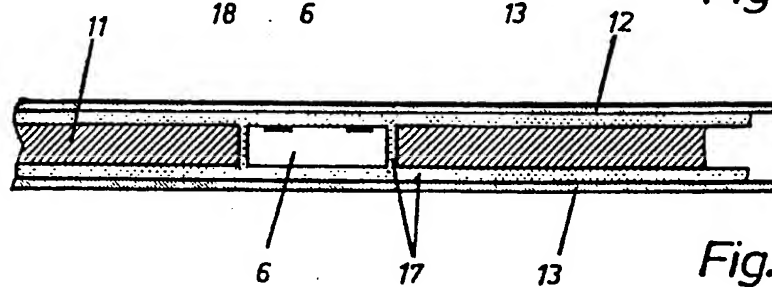


Fig. 3b

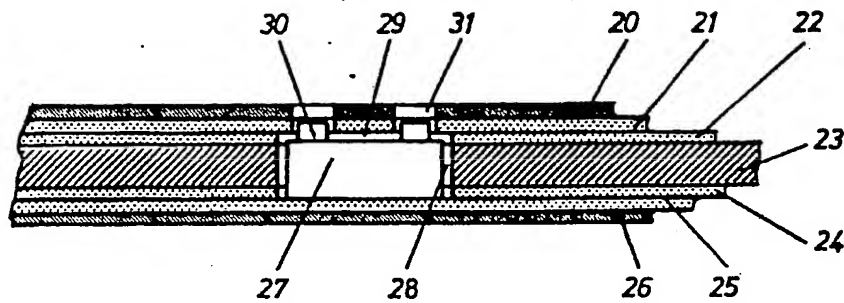


Fig. 4a

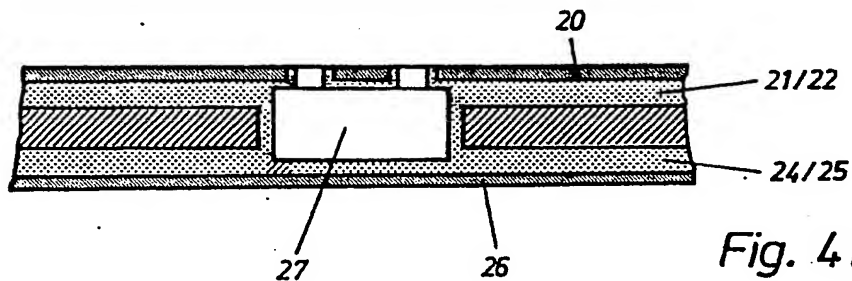


Fig. 4b

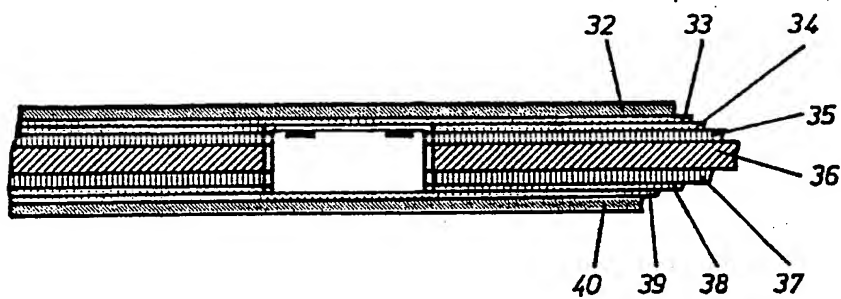


Fig. 5a

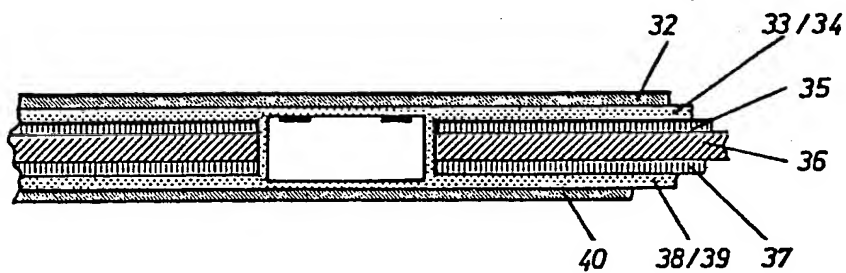


Fig. 5b